

穎威科技股份有限公司

WinWay Technology 法人說明會

2023/11/23

免責聲明

本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊，包括營運展望、財務狀況及業務預測等內容，係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊。

本公司未來實際所可能產生的營運結果、財務狀況與業務成果，可能與預測性資訊有所差異。其原因可能來自各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭態勢、各種政策法令與金融經濟現況之改變，以及其他本公司無法掌控之風險等因素。

本簡報中所提供之資訊，係反應本公司截至目前為止對於未來的看法，並未明示或暗示性地表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性。對於這些看法，未來若有變更或調整時，本公司並不負有更新或修正之責任。

公司概況

成立日期	西元 2001 年 4 月 10 日
服務項目	半導體測試介面研發設計及製造銷售
董事長兼總經理	王嘉煌
實收資本額	NTD 347,840,000
員工人數	887人
登記地址	高雄市楠梓區創意南路68號



經營理念

始終站在客戶的角度思考所有半導體測試需求，並透過客戶參與、技術創新、製造管理及供應鏈整合，持續堅持品質，服務全球，致力於為客戶、員工、供應商及股東創造最大的福利並善盡社會責任。



持續創新

透過技術創新
為客戶打造最佳測試介面解決方案



堅持品質

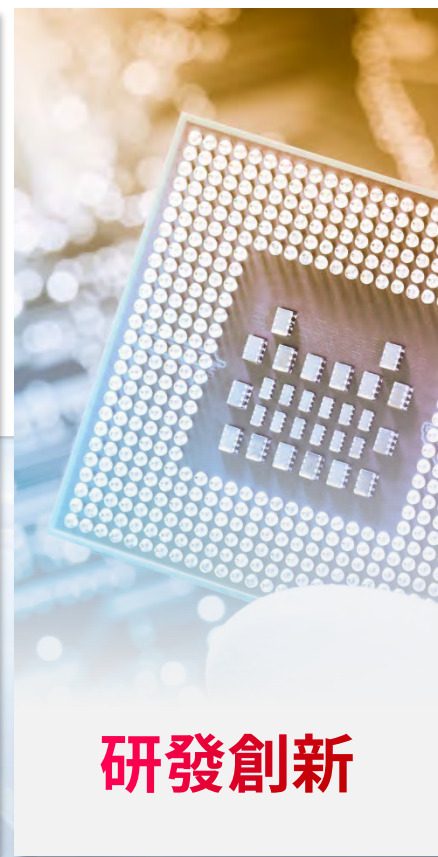
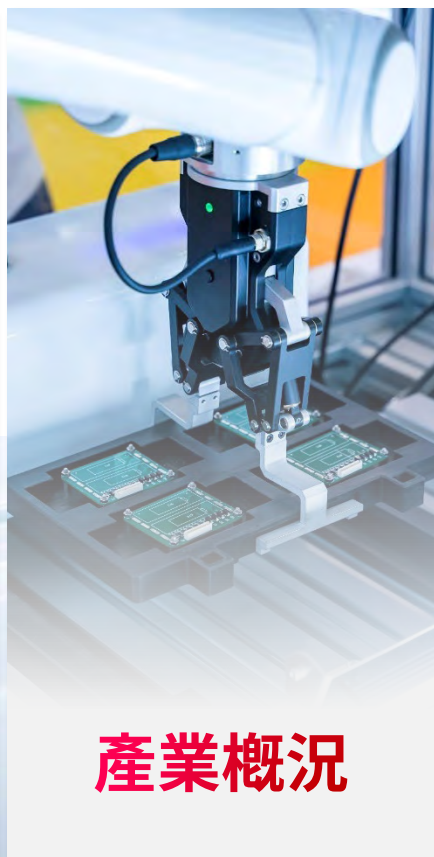
提供整體解決方案並於全球準時交付
超越客戶的品質要求



全球服務

致力成為全球領先的專業測試服務供應商
在 IC 測試各階段提供最佳服務

簡報大綱



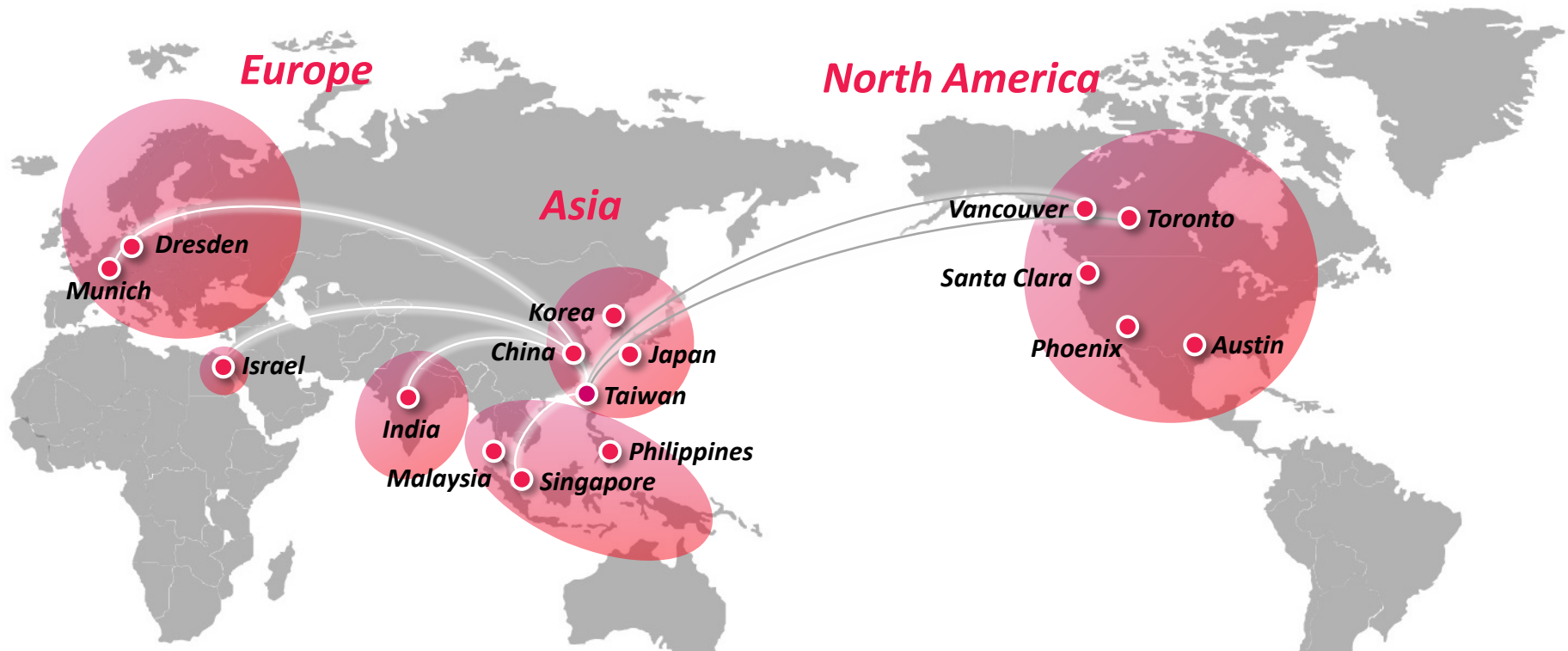
股票代號 6515



01

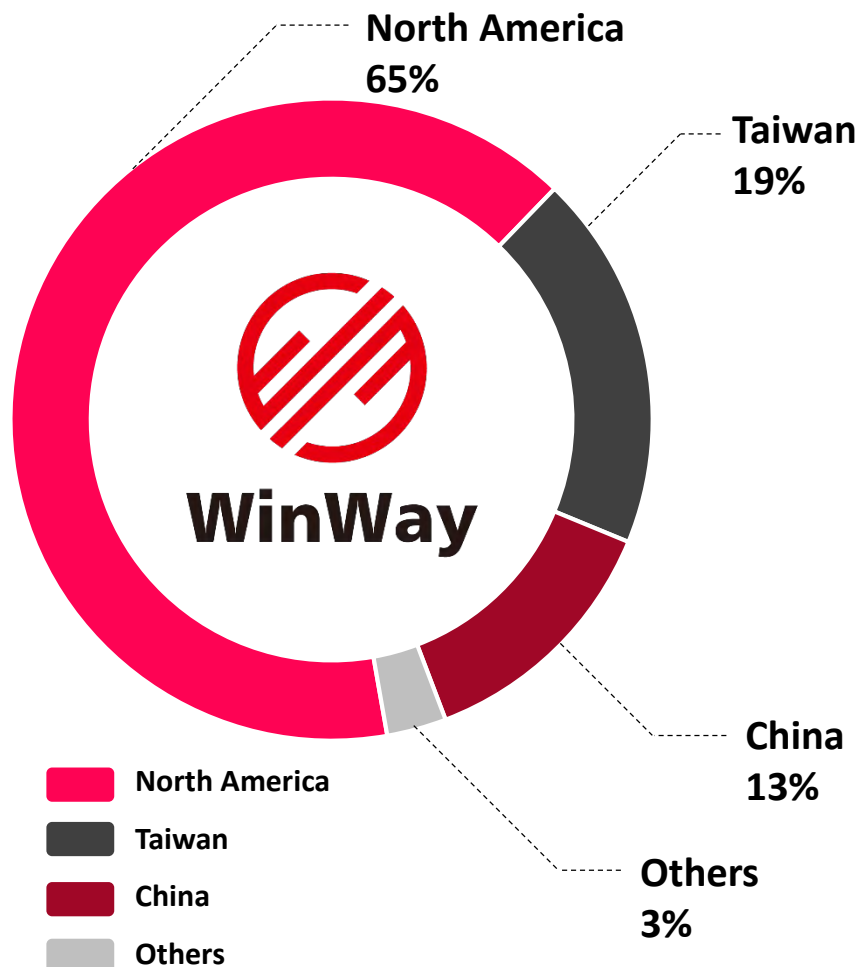
全球布局

技術創新 全球布局



- 高雄探針廠
- 高雄廠
- 新竹廠
- 蘇州廠

全球客戶



82%

Top10 IC Design

200+

Active Customers

股票代號 6515



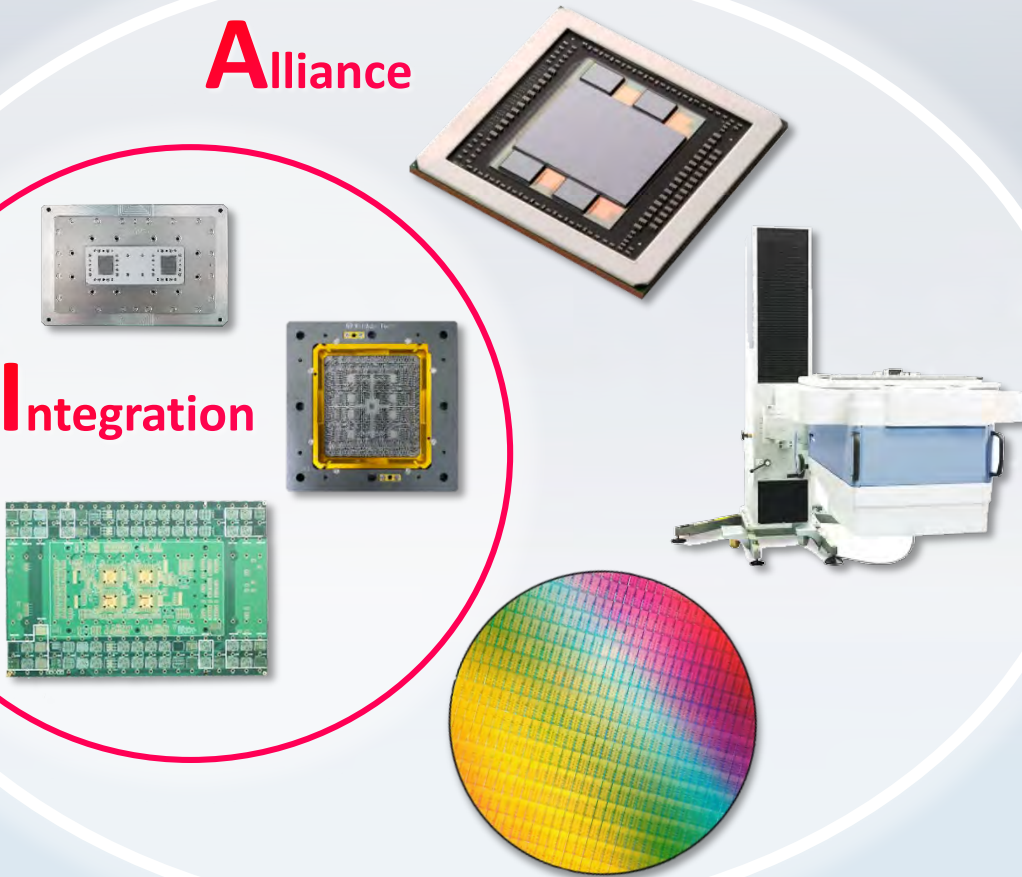
02

產業概況

半導體產業新契機

Alliance

Integration



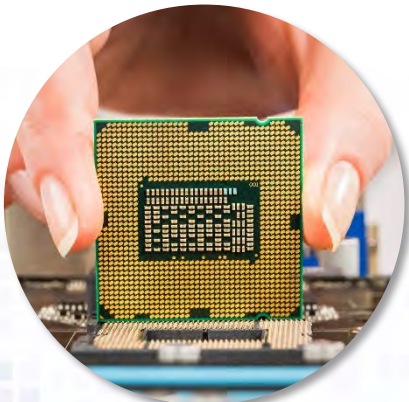
Artificial **I**ntelligence

CPU、GPU、HPC

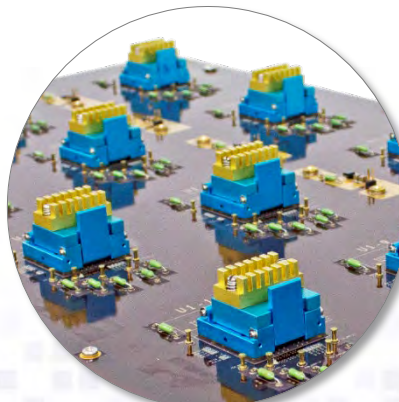


圖片來源：SEMI, Advantest

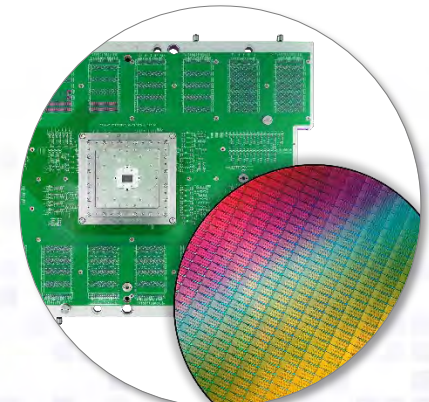
半導體測試完整解決方案



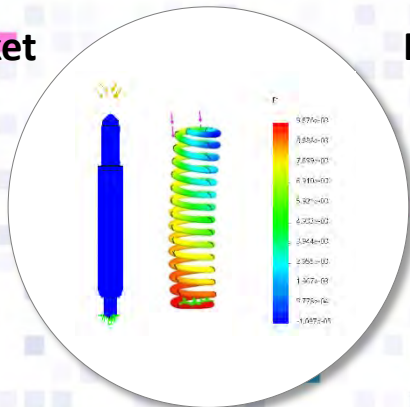
高頻高速
Coaxial Test Socket



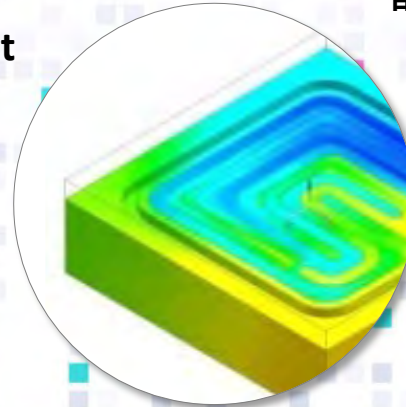
高階老化
Burn-in Socket



晶圓測試垂直探針卡
Vertical Probe Card

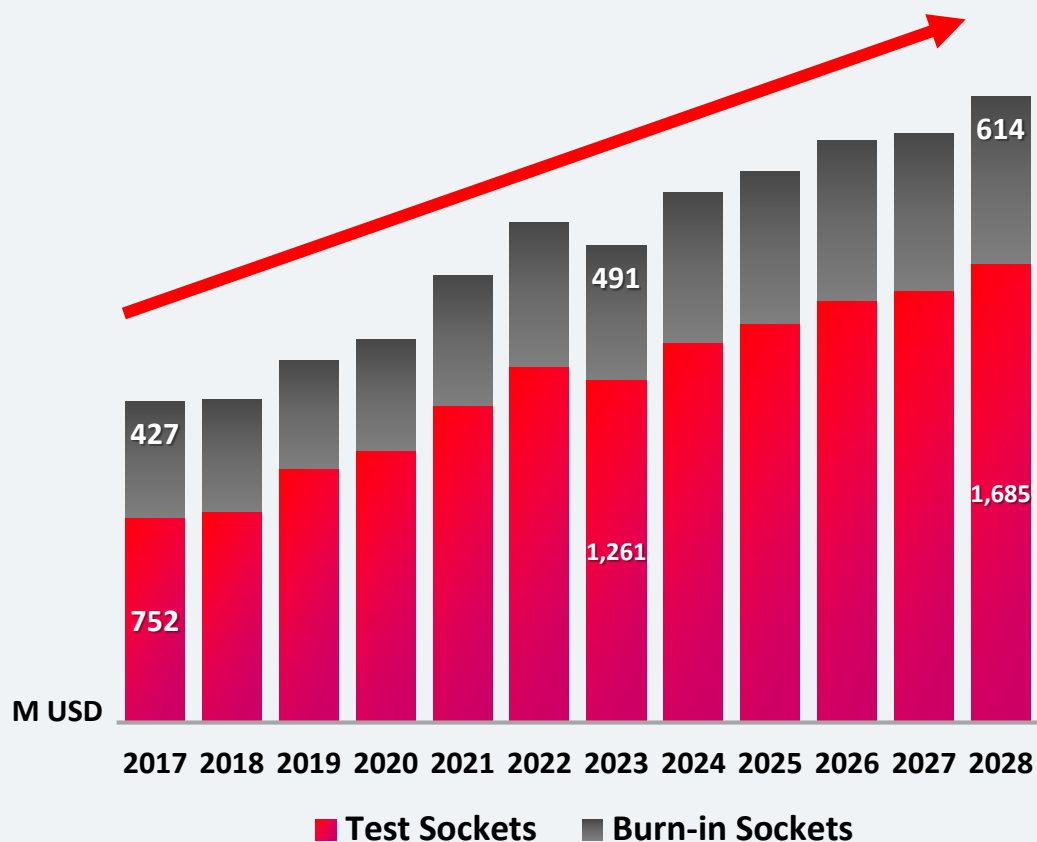


自製測試座探針
Spring Probe



溫控設備
Thermal Control System

系統測試需求 高速成長



資料來源：Yole, WinWay 2023

測試介面產業領導廠商

Test and Burn-in
Socket Ranking

6

Test Socket
Ranking

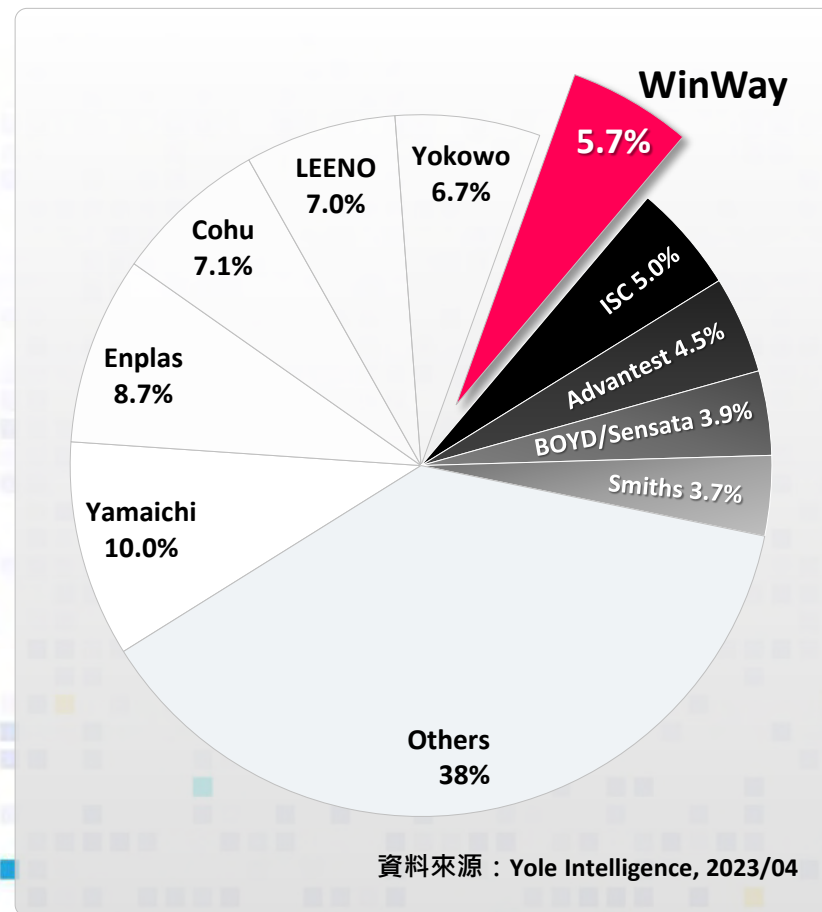
4

Probe Card
Ranking

15

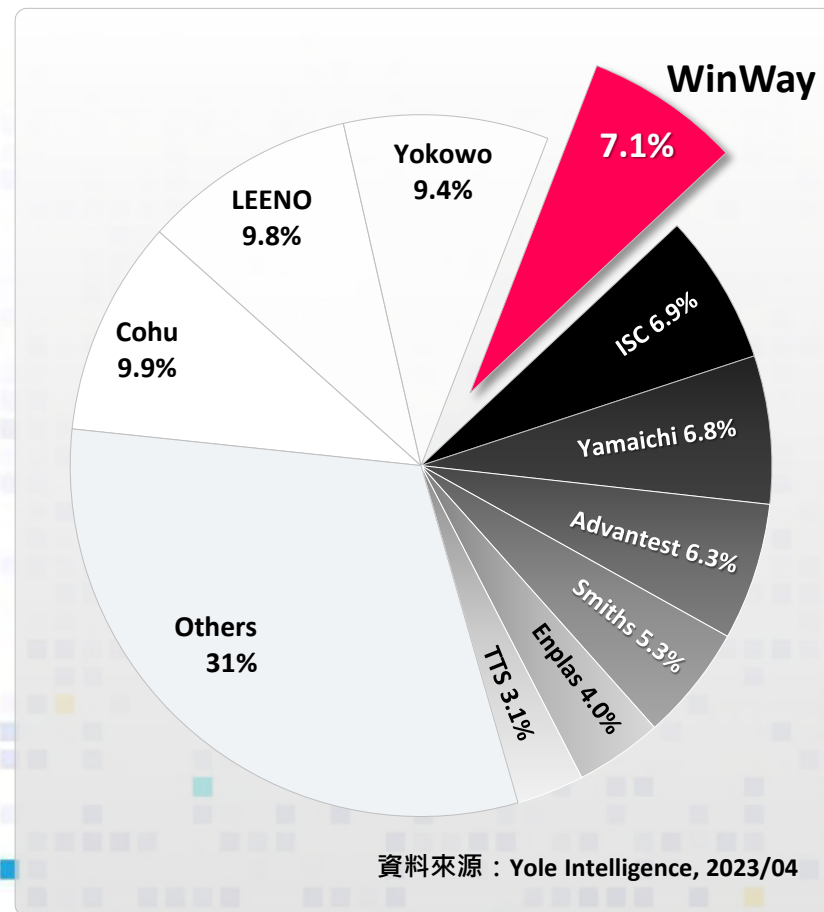
Test and Burn-in Socket Ranking (2022)

RANK	COMPANY	2021	2022	YoY %
1	Yamaichi	153.5	183.2	19.3%
2	Enplas	121.0	159.1	31.5%
3	Cohu	119.0	130.0	9.2%
4	LEENO	130.0	128.1	-1.4%
5	Yokowo	105.0	122.7	16.8%
6	WinWay	68.8	104.6	52.1%
7	ISC	96.7	92.3	-4.6%
8	Advantest	60.6	82.1	35.4%
9	BOYD/Sensata	55.0	72.0	30.9%
10	Smiths	43.3	68.8	58.9%
11	MCS	49.4	41.4	-16.2%
12	TTS	41.8	40.2	-3.9%
13	Johnstech	32.2	38.0	18.1%
14	Loranger	35.2	37.2	5.7%
15	Okins	34.2	33.0	-3.3%
16	TSE	31.4	31.4	0.1%
17	KZT	24.0	27.6	14.9%
18	3M ESD	26.0	26.7	2.5%
19	Qualmax	20.0	25.5	27.5%
20	NHK Spring	26.1	23.4	-10.5%



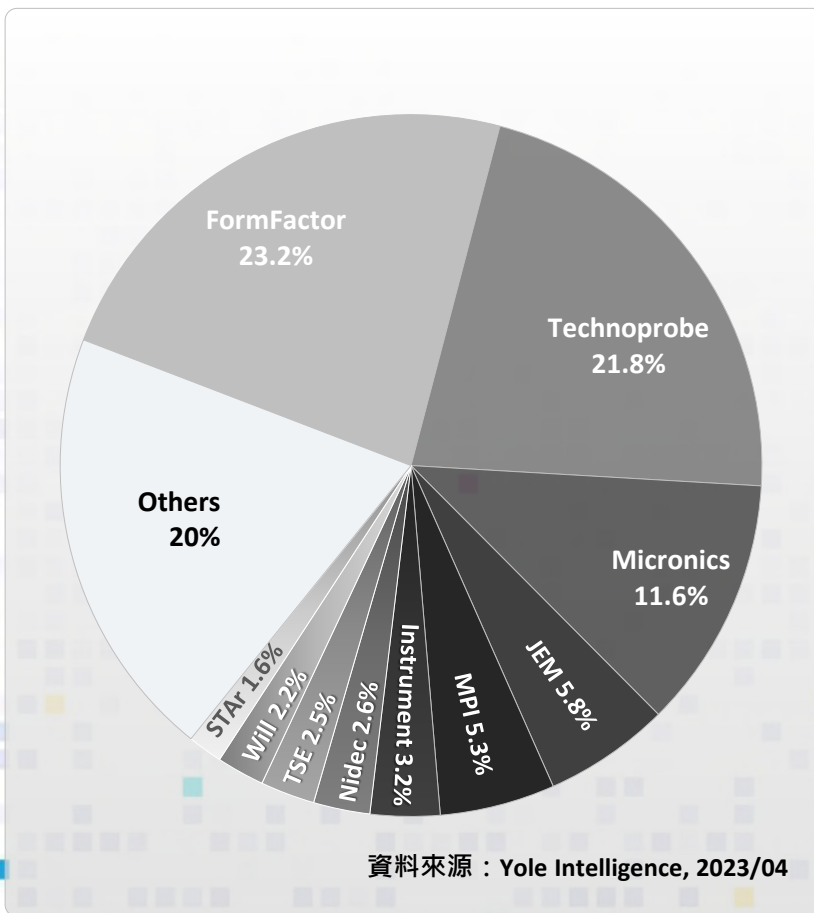
Test Socket Ranking (2022)

RANK	COMPANY	2021	2022	YoY %
1	Cohu	119.0	130.0	9.2%
2	LEENO	130.0	128.1	-1.4%
3	Yokowo	105.0	122.7	16.8%
4	WinWay	62.3	92.8	49.0%
5	ISC	94.6	90.4	-4.5%
6	Yamaichi	66.9	89.0	33.0%
7	Advantest	60.6	82.1	35.4%
8	Smiths	43.3	68.8	58.9%
9	Enplas	38.9	52.5	34.9%
10	TTS	41.8	40.2	-3.9%
11	Johnstech	32.2	38.0	18.1%
12	TSE	31.4	31.4	0.1%
13	Qualmax	20.0	25.5	27.5%
14	NHK Spring	26.1	23.4	-10.5%
15	Ironwood	15.2	17.4	14.1%
16	Loranger	15.2	16.8	10.6%
17	KZT	13.4	15.5	15.5%
18	Twin Solution	13.5	14.7	9.3%
19	FT Device	16.6	14.6	-12.0%
20	AEM	8.4	13.6	61.3%



Probe Card Ranking (2022)

RANK	COMPANY	2021	2022	YoY %
1	FormFactor	633.3	591.5	-6.6%
2	Technoprobe	450.3	555.8	23.4%
3	Micronics Japan	317.3	294.8	-7.1%
4	JEM	194.9	148.3	-23.9%
5	MPI	133.6	134.6	0.7%
6	Korea Instrument	72.9	81.6	12.1%
7	Nidec SV TCL	68.5	65.5	-4.4%
8	TSE	75.6	63.0	-16.6%
9	Will Technology	68.0	56.0	-17.7%
10	STAr Technologies	40.8	40.0	-2.0%
11	CHPT	60.0	37.3	-37.9%
12	Max One	18.8	36.8	96.0%
13	Yokowo	32.5	36.6	12.6%
14	Synergie CAD	36.9	33.1	-10.2%
15	WinWay	8.4	32.5	287%
16	FEINMETALL	33.3	31.0	-7.0%
17	Micro to Nano	26.5	30.1	13.6%
18	Microfriend	51.9	28.2	-45.6%
19	AMST	24.2	26.3	8.8%
20	Aehr	10.5	23.7	126%

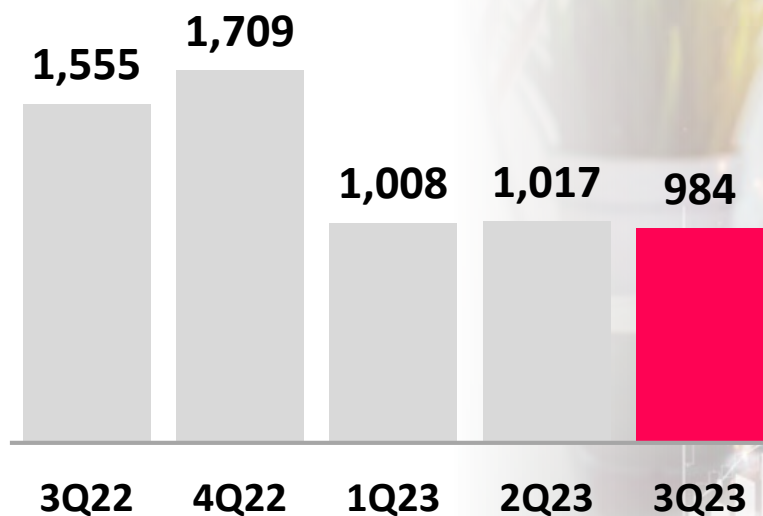


03

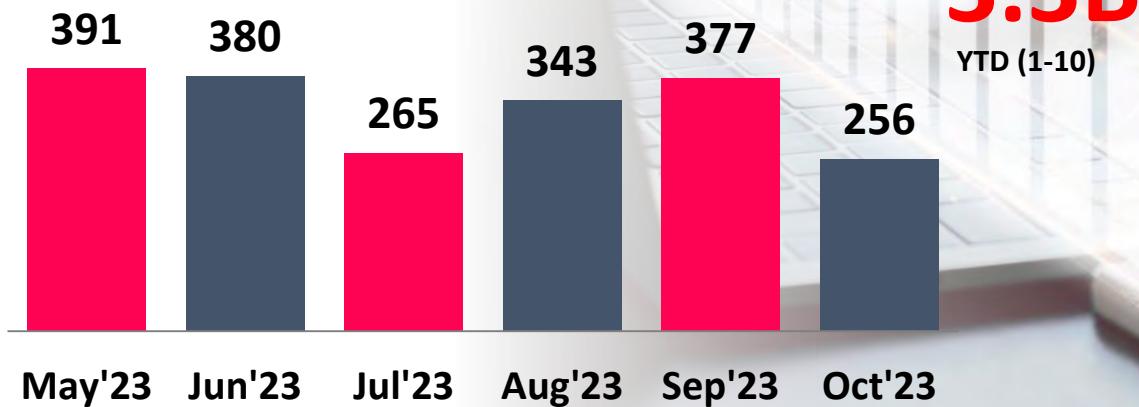
經營績效

營業收入

**QUARTERLY
REVENUE**
(NTD MILLION)



**MONTHLY
REVENUE**
(NTD MILLION)



獲利績效

EPS (1Q23~3Q23) **11.84**

— Gross Margin — Operating Margin — Net Margin

38%
35%
35%

19%
16%
13%

15%
13%
12%

1Q23

2Q23

3Q23

EPS

4.18

3.96

3.70

NET INCOME (NTD M)

143

136

127

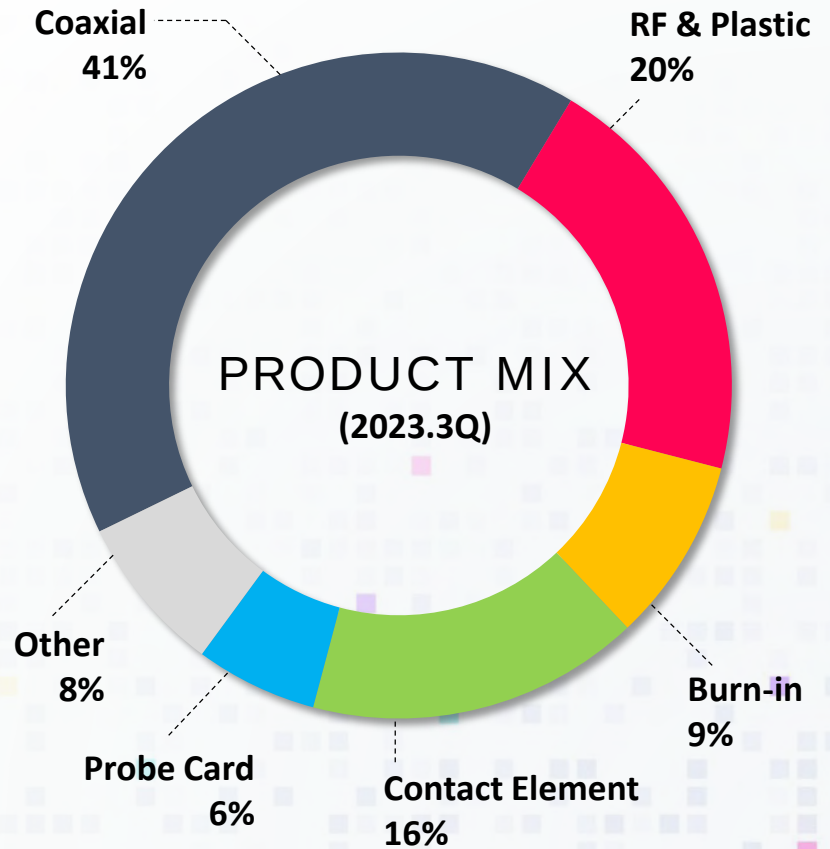
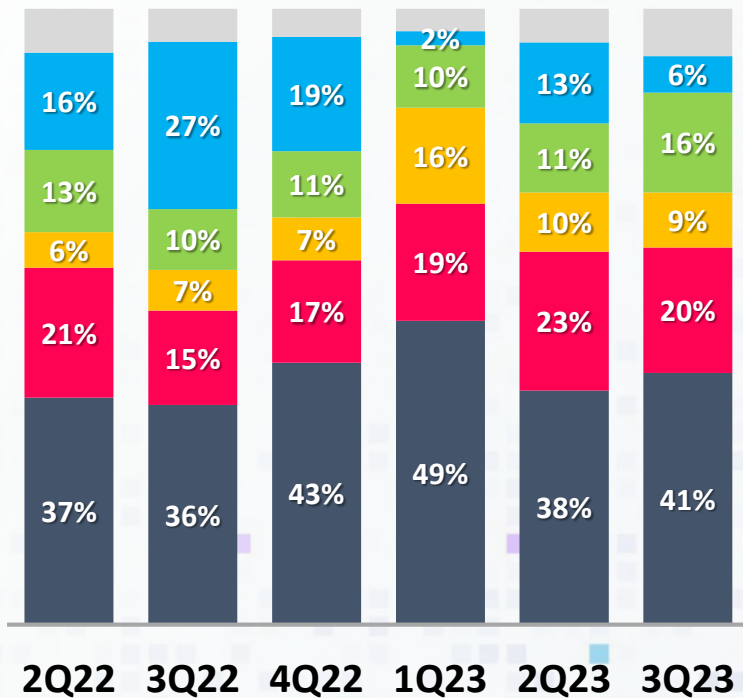
1Q23

2Q23

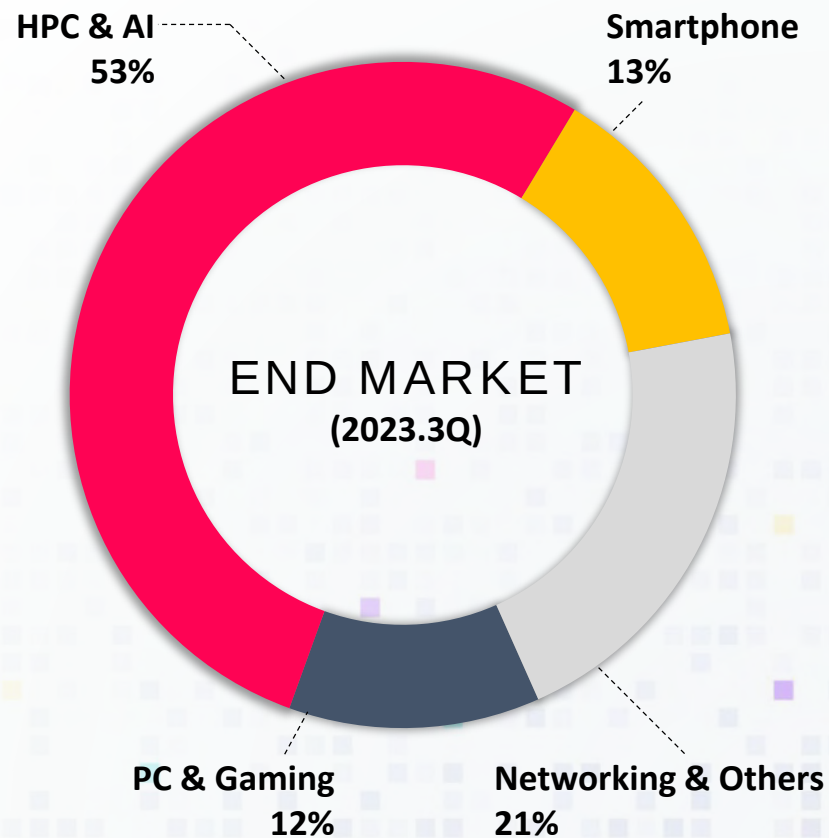
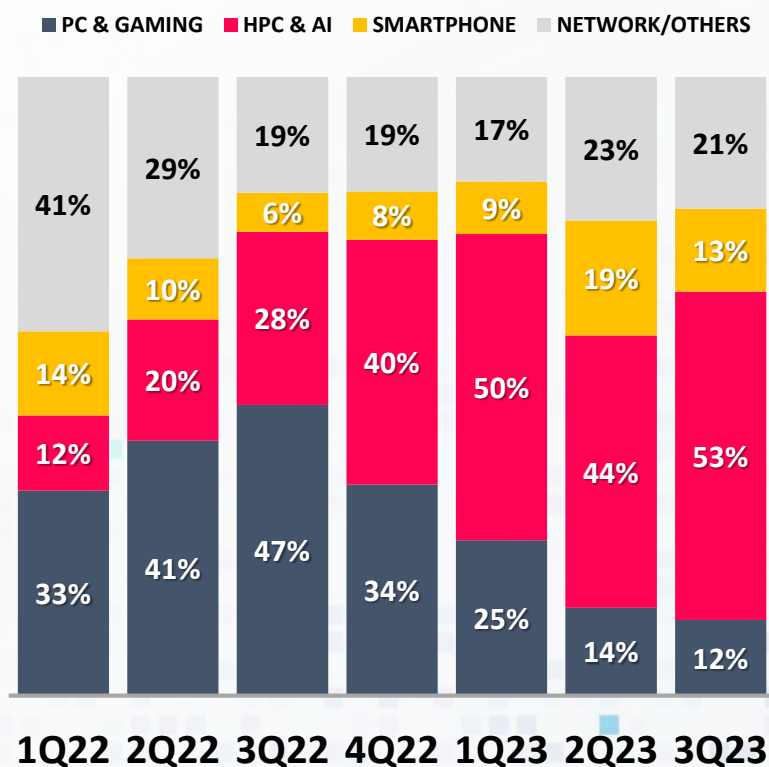
3Q23

產品組合

■ Coaxial ■ RF/Plastic ■ Burn-in ■ Contact Element ■ Probe Card ■ Other



市場應用



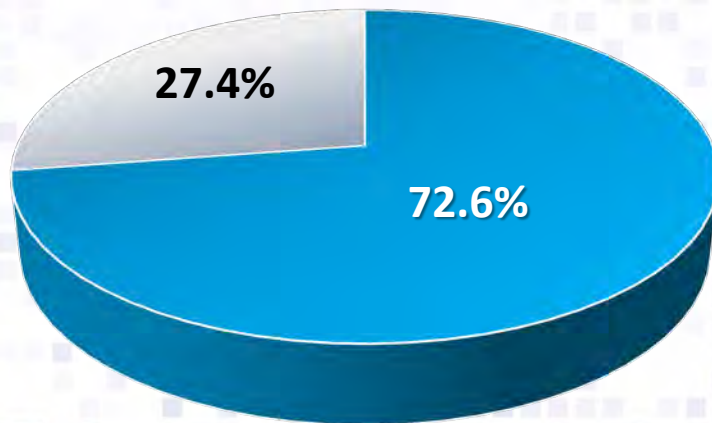
先進製程占比提升

7nm (or equivalent node) and below

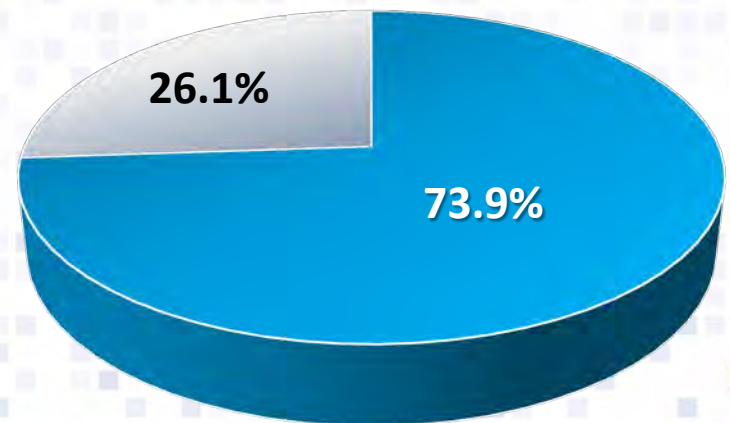
Mature Node

Advanced Node

2022



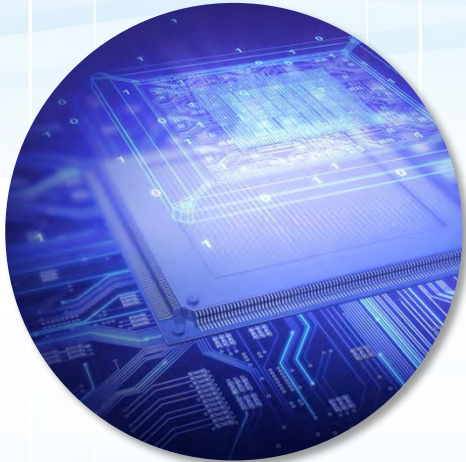
2023 (1-10)



04

研發創新

創新未來的核心驅動力



HPC



AI



Edge Computing

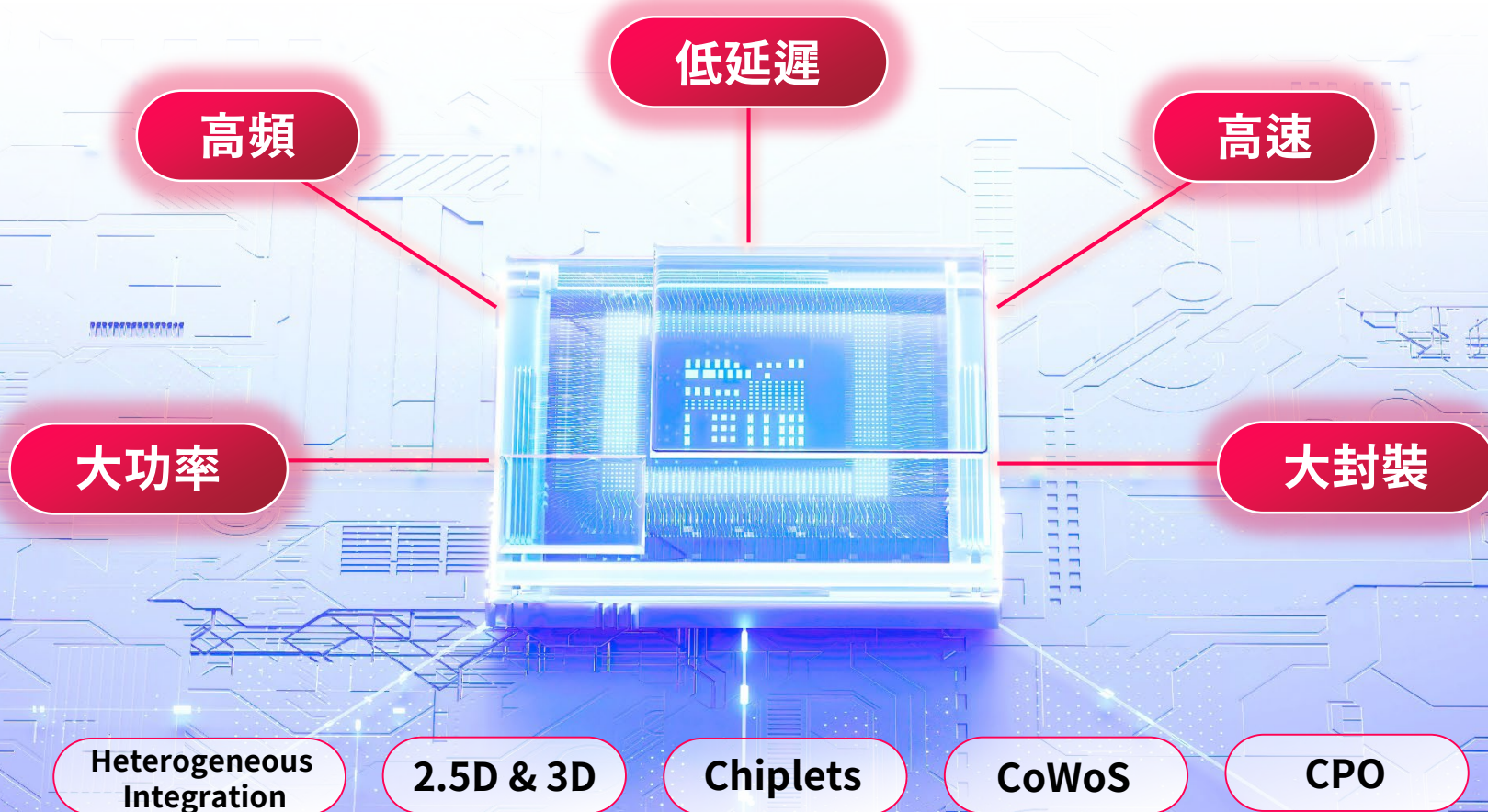


5G



Gaming

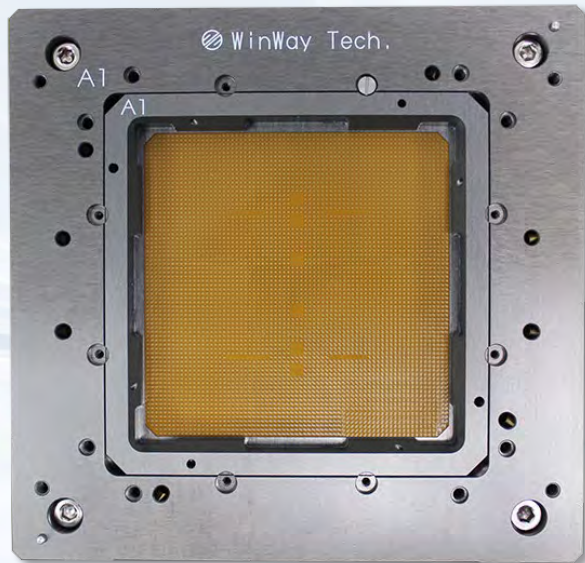
先進封裝引領高性能測試需求



跨世代全新測試座

WinWay Hybrid 解決方案

Patented Product



高速運算

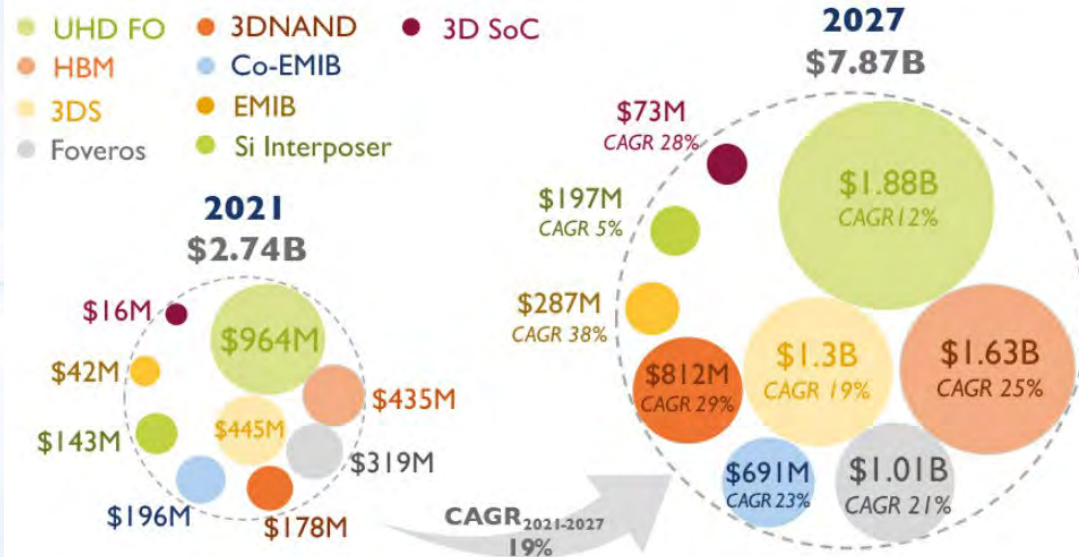
車用電子

AI伺服器

虛擬實境

2021 - 2027 high-end performance packaging market size by technology

(Source: High-End Performance Packaging 2022 – Focus on 2.5D/3D Integration report, March 2022)



資料來源：Yole Group, 2023

全球首創高頻高速測試座

SerDes PAM4 224Gbps

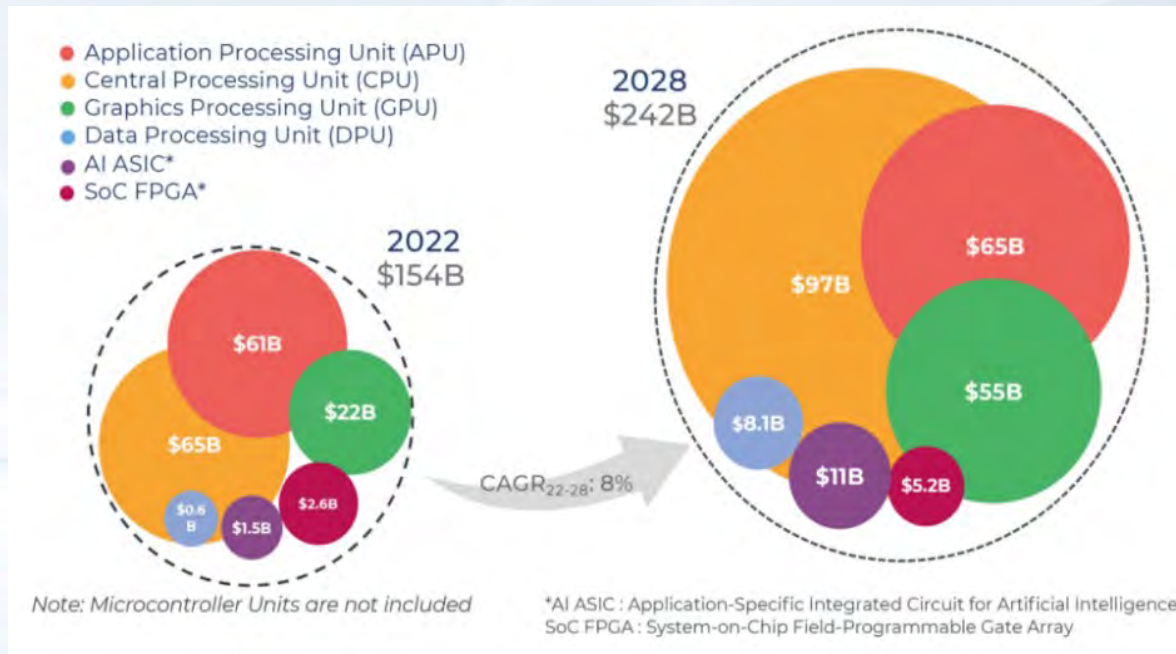
Patented Product



SerDes 224Gbps

PCIe Gen 7/GDDR7

滿足所有高速產品規格



資料來源：Yole Group, 2023

業界首推2000W超高功率散熱方案

HEATCon Titan溫控系統

Patented Product

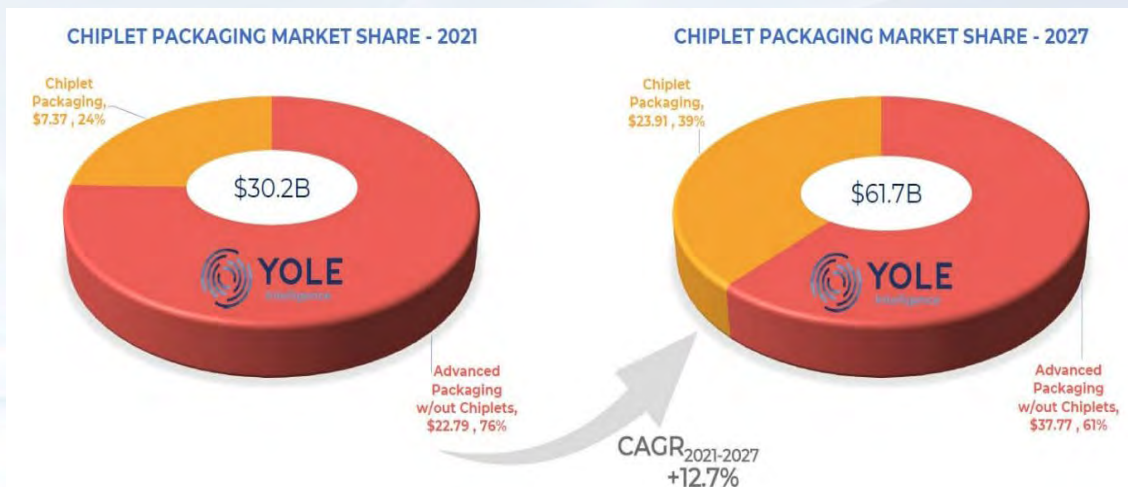
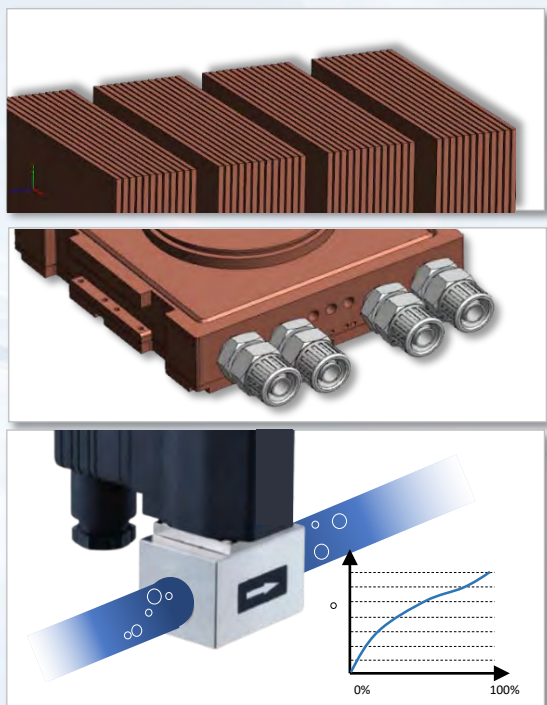


Figure 3: Chiplet packaging vs. other advanced packaging forecasts. (Yole Intelligence)

資料來源：Yole Group, 2023

Chiplet/3D封裝/CoWos

有效克服超大封裝功耗

改善晶片間多點發熱不均

整合關鍵技術業界首創 晶圓級CPO測試系統



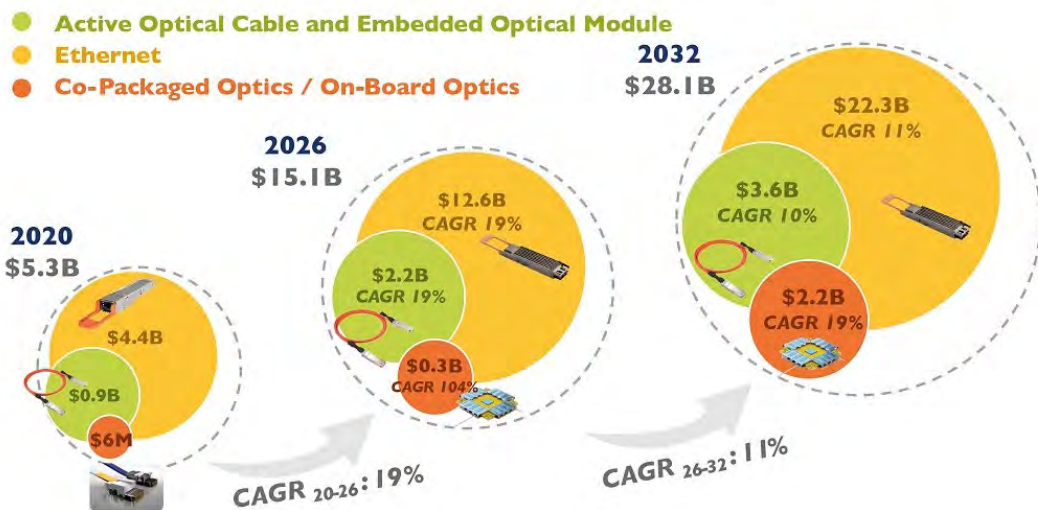
微間距對位雙邊探測系統

市場唯一矽光子光電同測方案

CPO 為800G/1.6T 傳輸規格主流

2020 vs. 2026 vs. 2032 datacom optics revenue growth forecast

(Source: Co-Packaged Optics for Data Centers 2022 report, Yole Développement, 2022)



資料來源：Yole Group, 2023

獨家研發自動化設備 高速植針換針系統

Patented Product

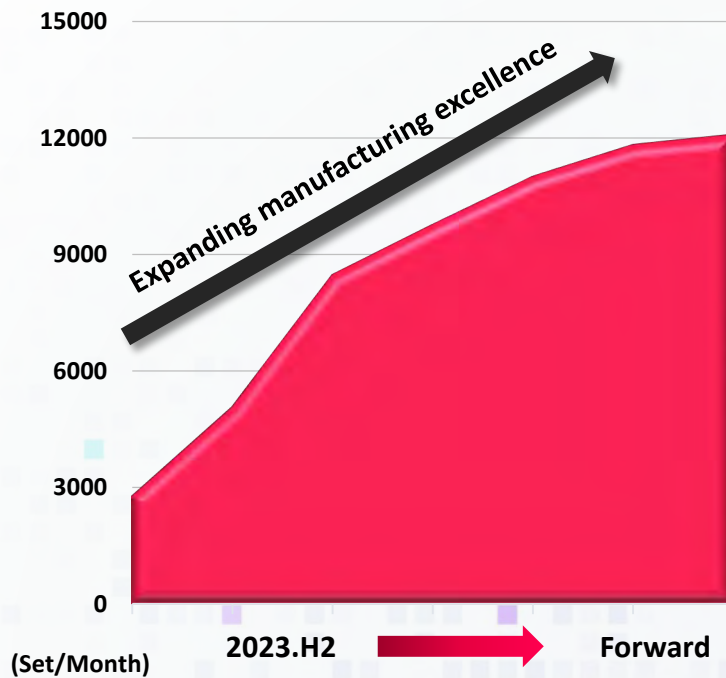
IC設計新產品導入驗證

滿足OSAT量產需求

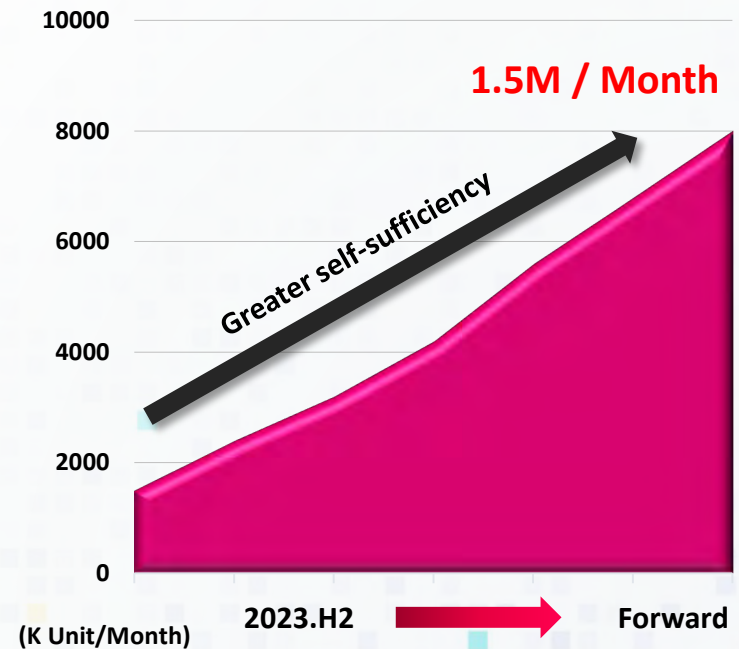


Socket自製探針 All in house

WW Socket Capacity (monthly)



WW Spring Probe Capacity



新竹台元廠辦

啟用日：2024 / Q1

總面積：900坪



2023

SEMICON JAPAN

December**13** / WED 10:00 – 17:00**14** / THU 10:00 – 17:00**15** / FRI 10:00 – 17:00**Tokyo Big Sight** (Tokyo International Exhibition Center)**East Exhibition Hall 1**

3-11-1 Ariake, Koto-ku Tokyo, Japan 135-0063

Welcome to visit us at NO. 1926



THANK YOU

You may contact WinWay Technology via

sales@winwayglobal.com

+886 7 361 0999 / +886 3 553 7632

www.winwayglobal.com